

Product Data

半導体用ジャンクションコーティング剤 TSJ3150

TSJ3150は、透明の1成分加熱硬化型半導体ジャンクションコーティング材です。加熱により硬化し、ジャンクションコーティング材として、優れた性能を発揮します。

特長

使いやすい1成分です。

透明で、光の透過性に優れています。

加熱硬化タイプです。

硬化後のゴムの硬さが低いので、ワイヤー、ハンダ、ペレットに対する応力を緩和します。

高純度で接着性に優れているため、半導体素子表面をイオン性不純物の汚染から保護します。

用途

トランジスタ、IC、サイリスタ、ダイオードその他半導体素子のジャンクションコーティング材

特性例

硬化前

項目	特性値
外観	淡黄色透明液状
粘度(23) Pa·s	1.2

硬化後(硬化条件; 150 、 4h)

項目	特性値
外観	淡黄色透明ゴム状
比重(23)	0.97
硬さ(タイプ A)	12
せん断接着強さ* MPa	0.2
体積抵抗率 M · m	1.0×10^7
絶縁破壊の強さ KV/mm	21
誘電率(60Hz)	2.7
誘電正接(60Hz)	0.001

* 被着体; アルミ

使用方法

TSJ3150 を半導体・ワークに塗布し、乾燥機などで加熱硬化してください。

半導体特性をさらに向上させるためには、高温加熱(200 以上)してください。

使用時の注意

取り扱い時は、保護眼鏡および必要に応じて保護手袋を使用してください。
局所廃棄装置を運転し、換気をよくしてご使用ください。

保管上の注意

室温保管では徐々に粘度が上昇しますので、冷蔵庫保管(0~10℃)してください。なお低温から室温に戻す際結露しますので、室温に戻してから開栓してください。

水、イオウ、窒素化合物有機金属塩、リン化合物などを含む表面では、硬化しないことがありますので部品の一部で予備試験を行ってください。有機ゴム、ハンドフラックス、アミン硬化エポキシ樹脂、ワックス類、縮合型シリコンゴムには特に注意してください。

子供の手の届かないところに保管してください。

荷姿・梱包

500g ポリ缶、1箱10本入り

消防法分類

危険物第四類第四石油類該当

発行:2000年10月

・本製品は、一般工業用途向けに開発・製造されたものです。医療用その他特殊用途に使用される場合は、貴社にてその安全性を事前にご試験ご確認のうえご使用ください。なお、体内に埋植、注入する用途、または体内に一部が残留するおそれのある用途には絶対に使用しないでください。
・記載のデータは、弊社の試験方法による実測値の一例で、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。なお、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
・製品改良のため、予告なく内容を変更する場合があります。
・安全性に関する詳細な情報につきましては、製品安全データシート(MSDS)をご参照ください。
・本資料を転載される場合は、弊社までご連絡ください。
・仕様書を要求される場合は、営業を通してお求めください。



モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社

<http://www.momentive.jp>

テクニカルアンサーセンター
東京本社(営業)
大阪支店
名古屋支店
九州営業所

TEL.0276-20-6182, 0120-975-400 FAX.0276-31-6259
TEL.03-5544-3111(代) FAX.03-5544-3122
TEL.06-6251-6272(代) FAX.06-252-8255
TEL.052-962-5731(代) FAX.052-962-5750
TEL.092-291-2056(代) FAX.092-262-1411